

证券代码：688120

证券简称：华海清科

华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、南方天辰、拾贝投资、九泰基金、汇安基金、谢诺辰阳、泓澄投资
时间	2024年11月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 王同庆 证券事务代表 王旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请问公司截至目前订单签订情况如何？后续订单展望怎样？</p> <p>A：近年来，公司产品性能指标和可靠性等得到客户的高度认可，市场占有率逐年提升，今年新签订单饱满，CMP 装备、晶圆再生等订单均有不错增幅，减薄装备已取得多个领域头部企业的批量 Demo 订单, 在手订单充足。未来，公司将继续以市场和客户需求为导向，持续践行“装备+服务”的平台化发展战略，推进减薄装备、划切装备、湿法装备等关键核心装备研发和产业化，积极争取更多订单和市场份额。</p> <p>Q2：麻烦拆分一下前三季度公司收入情况？</p> <p>A：从收入端来看，前三季度装备约占收入的 90%，其中以 CMP 装备收入为主，新产品减薄、清洗、SDS/CDS 装备等也在逐步贡献收入；配套材料及技术服务约占收入的 10%。</p> <p>Q3：公司毛利率及净利率一直不错，后续能维持吗？</p> <p>A：公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、</p>

降本增效等管理措施保持公司毛利率和净利率在一个相对稳定的水平。

Q4：公司 CMP 产品是否有议价的压力？

A：公司产品一直是在充分竞争背景下逐步发展的，议价是长期存在的，产品价格变动处于正常范围内。公司一方面通过核心零部件自制自研、培育零部件厂商等供应链管理控制生产成本，另一方面通过持续加大研发投入，推出满足客户更多材质工艺和更先进制程要求的新功能、新模块和新产品，提高议价能力。

Q5：请问公司在减薄领域布局有何进展？

A：公司积极把握 Chiplet 和 HBM 等先进封装领域的发展机遇，全面布局减薄装备、划切装备、边抛装备等，持续推进相关装备的研发验证工作。12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile - GP300 已于第三季度通过验收；面向封装领域的晶圆减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 已发往国内头部封测企业进行验证，目前验证顺利；满足集成电路、先进封装等制造工艺的 12 英寸晶圆边缘切割装备已发往多家客户进行验证。随着国内先进封装市场的发展，将大幅提升市场对减薄相关装备的需求，有助于巩固和提升公司的核心竞争力。

Q6：请问贵公司的半导体设备零部件国产化程度如何？如果美国等国家进一步加强零部件出口限制公司如何应对？

A：公司高度重视提升半导体设备核心零部件的国产化程度，不断打造、完善稳定的供应链体系以提升对风险的应对能力，积极推进国内零部件供应商的培养，目前公司零部件国产化率已处于较高水平，核心零部件均依靠自主研发，进口零部件大多为通用部件，且多为非半导体专用零部件，并未受到制约。同时，公司成立全资子公司华海清科（广州）半导体有限公司，建设半导体设备关键零部件孵化平台，培育一批有潜力的半导体设备专用高精密零部件项目，扩大市场竞争优势，并与公司现有

	<p>业务形成良性的互动和补足。</p> <p>Q7：公司发布天津二期厂区启用，对公司有何影响？</p> <p>A：天津二期项目为公司进一步扩大 CMP 装备及晶圆再生生产规模提供配套设施，通过优化提升产能，有助于保障公司进一步巩固和扩大市场份额。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 27 日